



公開研究会

3 DHIアライアンス公開研究会

- 13:00~13:05 「オープニング」 3DHI代表 井上史大 氏
- 13:05~13:35 「SUSS MicroTecのW2W/D2Wハイブリッドボンディング向けソリューション」
ズース・マイクロテック株式会社 石田 博之様
- 13:35~14:05 「JNCのプリントドエレクトロニクス材料の紹介」
JNC石油化学株式会社 杉原克幸様
- 14:05~14:35 「次世代半導体に向けた技術のご紹介」
田中貴金属工業株式会社 鍋谷 俊一様 牧田 勇一様
- 14:35~15:05 「高純度オゾンガスを用いたUV/プラズマフリーの真空プロセス技術（表面改質、成膜）のご紹介」
明電ナノプロセス・イノベーション株式会社 篠 竜徳様
- 15:05~15:20 休 憩
- 15:20~15:50 「半導体製造における課題解決を支える神戸製鋼グループの要素技術のご紹介」
株式会社 神戸製鋼所 田内 裕基様
- 15:50~16:20 「住友重機械工業における半導体事業への取り組み」
住友重機械工業株式会社 高橋 伸明様
- 16:20~16:50 「半導体後工程向け低誘電材料を用いたパルスレーザ微細直接加工技術」
ギガフォトン(株)&荒川化学工業(株)の共同 田崎 崇司様
- 16:50~17:00 「クロージング」 3 DHI理事長 齊藤 丈靖氏